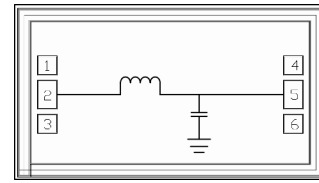


性能特点

- 通带频率: DC-3 GHz
- 通带插损: 1.2 dB
- 回波损耗: 25 dB
- 阻带衰减: 20 dB @4.8GHz; 40 dB @5.3GHz
- 芯片尺寸: 1.5X0.8X0.15 mm

功能框图



产品介绍

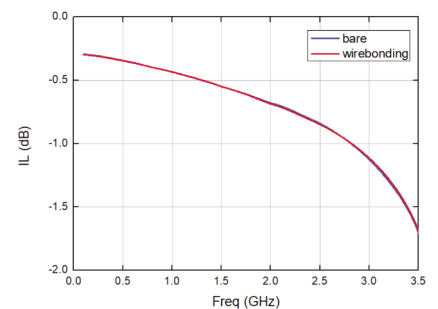
ZXA8003是一款低通滤波器芯片, 通带频率为DC- 3GHz, 通带插损1.2dB, 阻带衰减为20dB @4.8GHz、40dB @5.3GHz。该滤波器芯片采用了片上金属化通孔工艺, 无需额外的接地措施; 芯片背面进行了金属化处理, 适用于导电胶粘接或共晶烧结工艺。

电气性能参数 (TA = +25℃)

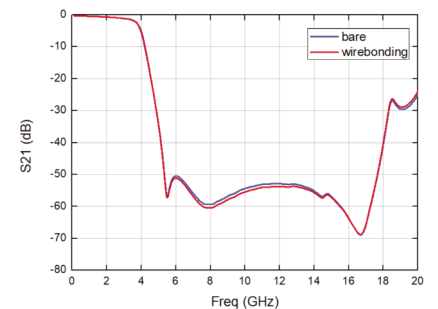
参数	最小值	典型值	最大值	单位
通带频率	DC		3	GHz
通带插损		1.2	1.5	dB
阻带衰减	20@4.8GHz			dB
	40@5.3GHz			dB
回波损耗		25		dB

典型测试曲线

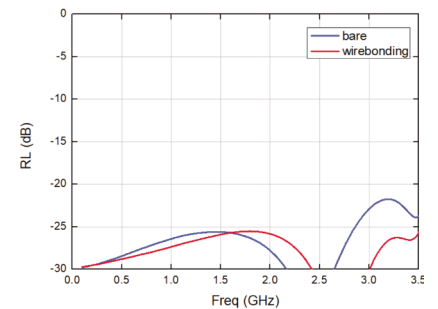
通带损耗 VS 频率



带外抑制 VS 频率



回波损耗 VS 频率



使用限制参数

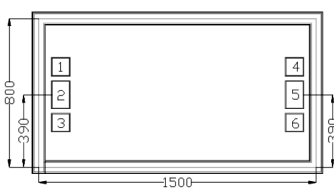
项目	数值
最高输入功率	+25 dBm
工作温度	-55 ~ +125 ℃
储存温度	-65 ~ +150 ℃



该产品对静电较敏感
使用中请注意防静电

*超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏

键合点定义



说明

1. 单位: μm
2. 芯片背面镀金接地
3. 键合压点尺寸: 150X100 μm

管脚	名称	描述
2	RF IN	射频信号输入端, 芯片内部无隔直电容
5	RF OUT	射频信号输出端, 芯片内部无隔直电容
1/3/4/6	GND	地焊盘, 片内接地
芯片输入与输出结构对称, 2、5端口可互换使用		

装配说明:

1. 芯片厚度100 μm 。
2. 在净化环境装配使用, 不要碰触表面, 以免损伤芯片;
3. 输入输出使用2根金丝键合 (直径25 μm), 键合线尽量短, 不要长于400 μm 。
4. 用Au80Sn20 金锡烧结, 温度不要超过300℃, 烧结时间不要超过 30 秒。
5. 本品属于静电敏感器件, 储存和使用时注意防静电。
6. 干燥、氮气环境下保存。

装配示意图

